

半导体新闻周报

汇报时间：2025.12.05

目录

一. 美光科技拟在日本投资96亿美元建设新存储器芯片工厂.....	3
二. 胜科纳米投资5亿元加速青岛半导体检测项目布局.....	5
三. 清溢光电：佛山南海基地已投产 高精度平板显示掩膜版项目即将进入量产阶段.....	7
四. 入股斯多福 利安隆再拓展电子新材料布局.....	9
五. 青岛集成电路产教联合体在青岛自贸片区正式启动.....	11
六. 强“芯”壮链，共赴“芯”征程 国际集成电路展览会暨研讨会（IIC Shenzhen 2025）圆满落幕 “全球电子元器件分销商卓越表现奖”隆重揭晓.....	12
七. NAND Flash wafer供给紧缩加剧，11月部分产品合约价涨幅逾60% TrendForce集邦咨询.....	13
八. 亚马逊发布Trainium3 AI芯片.....	14
九. 三星电子第六代HBM4芯片开发完成，量产目标2025年底.....	16
一〇. 存储器价格飙升冲击游戏主机毛利，2026年出货量预估将下调 TrendForce集邦咨询	18

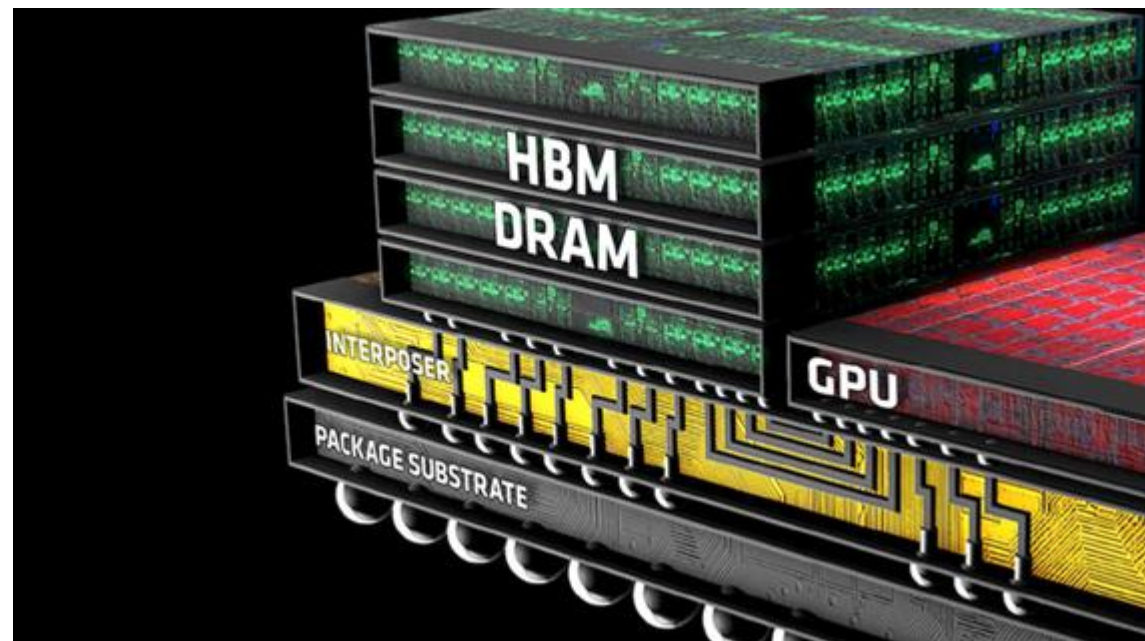
①美光科技拟在日本投资96亿美元建设新存储器芯片工厂

2025. 12. 01

美光科技 (Micron Technology) 宣布将在日本广岛投资1.5兆日元（约96亿美元），建设一座专门生产高频宽存储器（High-Bandwidth Memory, HBM）芯片的新工厂。该工厂将设于美光现有的广岛厂区内，预计于2026年5月动工，并于2028年左右开始出货HBM芯片。

此举不仅是为了扩大美光的生产能力，更是为了分散地缘政治风险。随着人工智慧（AI）与数据中心需求的快速成长，HBM芯片已成为支援AI运算的关键元件，广受NVIDIA、OpenAI、Meta Platforms等科技巨头青睐。

日本经济产业省（METI）将为此项目提供高达5,000亿日圆的补助，以支持日本半导体产业的复苏与发展。此外，日本政府自2021年起已编列约5.7兆日圆的预算，推动半导体与AI技术的发展，并在近期追加2,525亿日圆的特别预算，进一步强化产业支援。



- 美光科技公司
- Micron Technology, Inc
- 成立时间：1978年10月5日
- 地点：美国爱达荷州波夕
- 官网：<https://www.micron.cn/>
- 美光科技公司（英语：Micron Technology, Inc.，NASDAQ: MU），简称美光科技，是美国一家总部位于爱达荷州波夕的半导体制造公司，于1978年由Ward Parkinson、Joe Parkinson、Dennis Wilson和Doug Pitman创立。其主要业务为生产各种半导体器件，包括动态随机存取存储器，闪存和固态驱动器；其主要产品包括DRAM、NAND闪存、CMOS影像传感器、其它半导体器件和存储器模块。



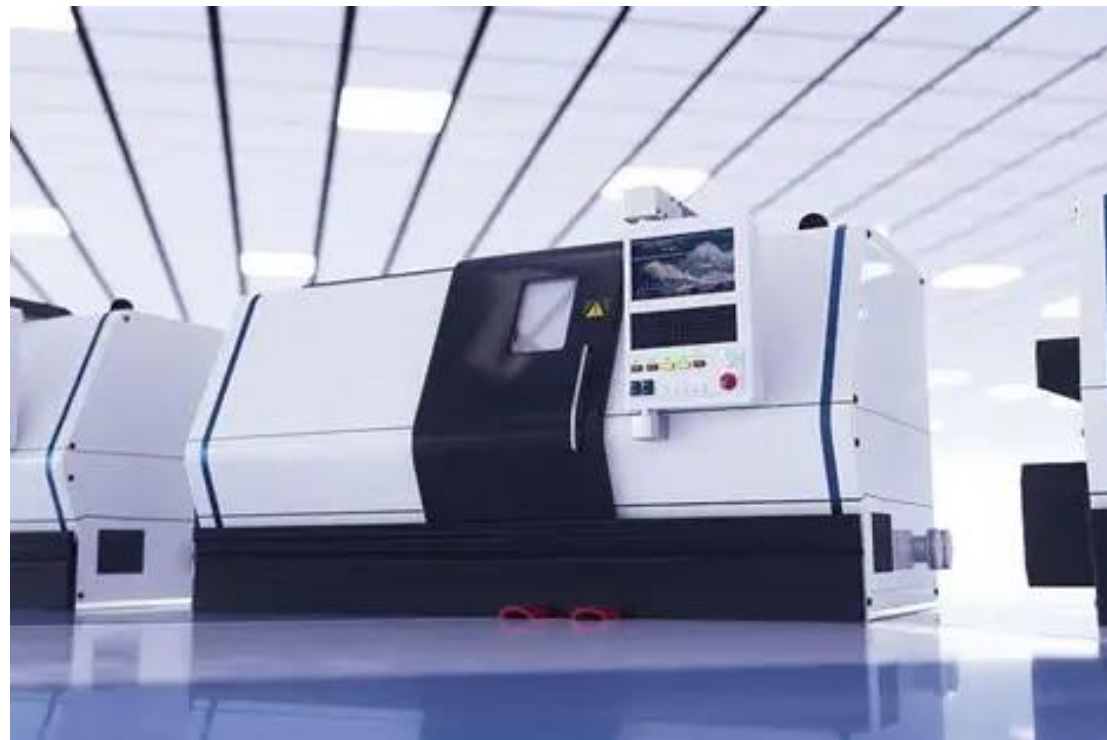
②胜科纳米投资5亿元加速青岛半导体检测项目布局

2025. 12. 01

胜科纳米（苏州）股份有限公司于2025年11月28日晚间宣布，其全资子公司胜科纳米（青岛）有限公司计划投资约5亿元人民币，建设“青岛检测分析能力提升建设项目”。该项目旨在进一步完善公司在全国市场的布局，并增强其在半导体第三方检测领域的竞争力。

根据公告，项目资金将通过自有资金、银行贷款及其他合法方式筹集，最终投资总额将根据实际投入确定。项目选址在山东省青岛市，具体用地面积将根据实际情况而定。核心建设内容包括新建第三方检测实验室，并引进各类专业分析检测仪器，重点拓展失效分析、材料分析和可靠性分析等检测服务。

业内专家指出，青岛及其周边地区已形成较为完整的集成电路产业生态，企业对半导体检测服务的需求日益增长。胜科纳米的本地化布局将有助于更好地满足区域内企业的检测需求，缩短服务时间，降低物流成本，并提升客户的忠诚度。



补充信息—胜科纳米（苏州）股份有限公司



- 胜科纳米（苏州）股份有限公司
- 成立时间：2012年8月17日
- 地点：苏州工业园区朝前路9号
- 官网：<https://www.wintech-nano.com/Introduction.html>
- 股东信息：

李晓旻	39.41%
宁波丰年荣通投资管理有限公司	
– 宁波梅山保税港区丰年君和创业投资合伙企业	6.22%
江苏鸢翔技术咨询有限公司	6.02%
深圳市高捷金合创业投资管理有限公司	
– 深圳市高捷智慧股权投资基金合伙企业	5.92%
苏州禾芯企业管理咨询合伙企业	4.97%
苏州纳川投资管理有限公司	
– 苏州工业园区苏纳同合纳米技术应用产业基金合伙企业	4.34%
苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业	
– 苏州永鑫融畅创业投资合伙企业	2.74%



③清溢光电：佛山南海基地已投产 高精度平板显示掩膜版项目即将进入量产阶段

2025. 12. 01

近日，**清溢光电**在互动平台表示，公司佛山南海生产基地已于2025年11月14日举办投产仪式，高精度平板显示掩膜版项目即将进入量产阶段，高端半导体掩膜版项目也在紧锣密鼓进行量产准备中。

其中，高精度平板显示掩膜版基地主要生产8.6代及以下高精度FPD掩膜版，特别是填补国内AMOLED高精度掩膜版空白，满足5G、AI时代高清化、柔性化显示需求；高端半导体掩膜版基地则专注于180nm-28nm制程半导体掩膜版生产。佛山南海生产基地的投产将进一步扩大公司生产规模。

资料显示，清溢光电是国内掩膜版行业的领先企业，创立于1997年8月，由清溢精密光电（深圳）有限公司整体改制而来，并于2019年11月20日在上交所科创板上市。主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，下游涵盖消费电子、车载电子、人工智能等多个领域。



补充信息—清溢光电

- 深圳清溢光电股份有限公司
- 成立时间：1997年08月25日
- 官网：<https://www.supermask.com/>
- 地址：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼
- 股东信息：

苏锡光膜科技（深圳）有限公司	27.51%
光膜（香港）有限公司	23.5%
广东省广新控股集团有限公司	8.55%
方舟互联（深圳）私募股权基金管理合伙企业	
– 智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业	2.54%
湖北省铁路发展基金有限责任公司	2.54%
广东粤科资本投资有限公司	0.89%
安徽固信私募基金管理有限公司	
– 马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业	0.64%
中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业	0.64%
古颂谦	0.64%
诺德基金 – 国泰君安证券股份有限公司	
– 诺德基金浦江599号单一资产管理计划	0.46%



④入股斯多福 利安隆再拓展电子新材料布局

2025. 12. 01

利安隆27日公告，公司以自有资金5000万元对深圳斯多福新材料科技有限公司进行战略投资，天津天开海河海棠高教创业投资合伙企业（有限合伙）同步出资1000万元。交易完成后，利安隆将持有斯多福25%股权，斯多福仍保持独立运营；天开海棠基金持有5%股权，斯多福投后估值为2亿元。

公开资料显示，利安隆主营高分子材料抗老化业务，近年来持续推进多元化战略，目前已形成三大业务曲线协同发展的格局。此前通过并购韩国IPITECH INC. 切入电子级聚酰亚胺新材料业务，向柔性OLED显示屏幕、柔性电路板、芯片封装、新能源汽车等制造使用的核心材料产业延伸。此次投资是公司在该领域的又一重要布局。

公告显示，标的公司斯多福深耕电子粘胶剂行业，该产品作为电子产业核心辅助材料，在半导体封装、显示面板、新能源汽车等领域需求持续增长，其中高端产品长期依赖进口。



补充信息—利安隆

- 天津利安隆新材料股份有限公司
- 成立时间：2003年8月8日
- 地点：天津经济技术开发区汉沽现代产业区黄山路6号
- 官网：<https://www.rianlon.cn/company/about-us>
- 股东信息：

天津利安隆科技集团有限公司	14.14%
利安隆国际集团有限公司	10.91%
天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业	6.87%
韩伯睿	2.86%
天津圣金隆企业管理合伙企业	2.72%
韩厚义	2.01%
天津利安隆新材料股份有限公司 - 第三期员工持股计划	1.76%
红杉锦程（厦门）股权投资合伙企业	1.45%
韩谦	1.19%
天津融创私募股权投资基金管理有限公司	
- 天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业	1%



⑤青岛集成电路产教联合体在青岛自贸片区正式启动

2025. 12. 01

11月28日，青岛集成电路产教联合体工作推进会在青岛自贸片区召开，正式成立理事会，集成电路实训主基地和三个分基地进行揭牌，标志着青岛集成电路产教联合体进入实体化运行。

据悉，青岛集成电路产教联合体目前共有48家成员单位，由青岛集成电路产业发展相关的企业、学校院校、科研机构、行业组织、政府等单位组建。

青岛集成电路产教联合体以青岛市集成电路产业园为基础，作为全市首批高水平新兴产业专业园区，青岛市集成电路产业园自2022年11月26日揭牌成立三年来，青岛自贸片区和中德生态园全力推进项目建设、促进投资、稳定增长。产业园落户项目数量从16个增至49个，完成投资额度从530亿元增至1250亿元，园区营业收入从13亿元跃升至65亿元，持续领跑青岛市新兴产业专业园区，连续三年入围“中国集成电路产业园综合实力TOP30”榜单，推动青岛市连续两年跻身全球集成电路产业综合竞争力百强城市。



⑥强“芯”壮链，共赴“芯”征程 国际集成电路展览会暨研讨会（IIC Shenzhen 2025）圆满落幕 “全球电子元器件分销商卓越表现奖”隆重揭晓

2025.12.01

【2025年11月26日 — 深圳讯】2025年11月26日，为期两天的“国际集成电路展览会暨研讨会”（IIC Shenzhen 2025）圆满落幕。此次盛会精彩纷呈，汇聚全球优秀展商，轮番呈现多场高质量主题活动，为半导体产业的国际合作与创新发展注入新动能，充分展现了行业的蓬勃活力与技术前沿，吸引了来自世界各地的专业观众踊跃参与。

中国信息产业商会电子元器件应用与供应链分会理事长周继国做开场致词，演讲嘉宾包括：铭冠国际CEO燕青， Co-founder & CEO of Adesio Bertier Luyt，森德国际海外总监刘美希，赫联电子区域销售总经理刘建洋，睿查森电子亚太区市场总监李国君，Aspencore中国区主分析师Echo Zhao，璞励咨询（深圳）有限公司管理合伙人麦满权博士，迪文科技全国销售总监卢冉，芯片超人创始人&CEO姜蕾（花姐）， Founder of ARDl Logistics, Co-Founder Ardi Express, Founder of Stealtho Vitalii Savryha。



⑦NAND Flash wafer供给紧缩加剧，11月部分产品合约价涨幅逾60% |

TrendForce集邦咨询

2025.12.01

根据TrendForce集邦咨询最新调查，2025年11月整体NAND Flash需求持续受AI应用与Enterprise SSD（企业级SSD）订单强力拉动，原厂优先分配产能给获利能力较好的高阶和企业级产品，且旧制程产能快速收敛，wafer供应情况更加紧绷，导致十一月主流wafer合约价全面大幅上涨，各类产品平均月涨幅可达20%至60%以上，涨势快速扩散至所有容量段。

观察11月各类NAND Flash wafer价格表现，1Tb TLC因Enterprise SSD需求持续成长，供给短缺最为严重，十一月均价大幅上涨。512Gb TLC因旧制程转产导致供应急缩，加上市场需求稳健，推升其价格涨幅成为十一月TLC系列产品之冠，月增超过65%。256Gb TLC受旧制程退出影响，供给量再度下滑，价格持续显著成长。

由于企业级高容量产品需求爆发，加上冷储存应用出货加速，QLC供应明显吃紧，1Tb QLC十一月均价也大幅上涨。MLC产品有工控及消费性产品需求支撑，均价持续走扬。



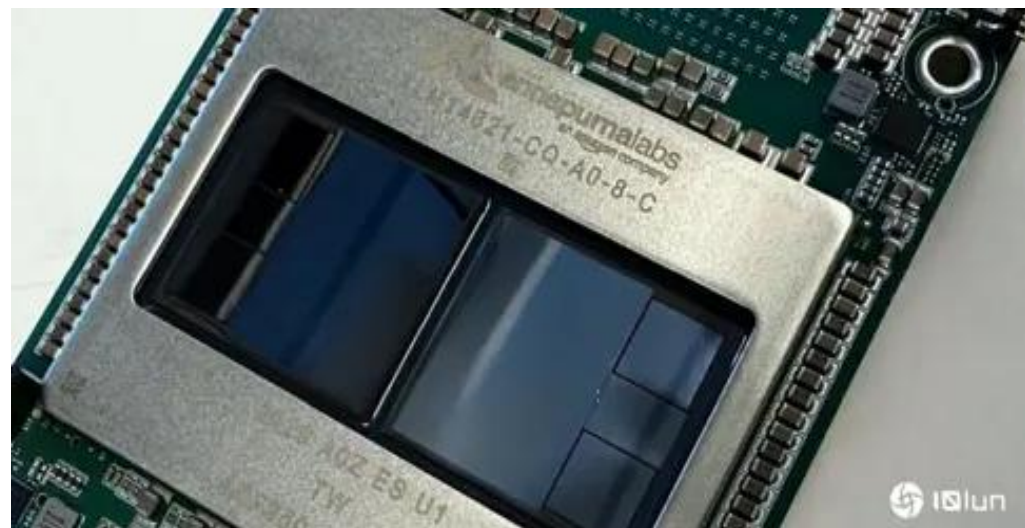
⑧亚马逊发布Trainium3 AI芯片

2025. 12. 03

在2025年12月2日的AWS re:Invent大会上，[亚马逊云服务（AWS）](#)正式推出其最新一代AI芯片Trainium3。Trainium3是AWS首款采用3纳米制程技术的AI芯片，专为训练与服务下一代生成式AI、推理、多模态与视频生成等应用而设计。

根据AWS官方资料，Trainium3芯片单颗提供高达2.52 petaflops（PFLOPs）的FP8运算效能，内存容量提升1.5倍、带宽提升1.7倍，达到144 GB HBM3e内存与4.9 TB/s内存带宽。Trainium3 UltraServer系统整合最多144颗Trainium3芯片，单一系统可提供最高20.7 TB HBM3e内存、706 TB/s内存带宽与362 PFLOPs FP8运算效能，相较于前一代Trainium2 UltraServer，运算效能提升4.4倍、内存带宽提升3.9倍，能效提升超过4倍。

Trainium3支持先进数据格式（如MXFP8与MXFP4），并针对密集与专家平行（expert-parallel）工作负载进行优化，适合强化学习、Mixture-of-Experts（MoE）、推理与长上下文架构等应用。AWS同时扩展Neuron开发框架，支持原生PyTorch与开源组件，让开发者能更轻松地在Trainium3上部署与优化AI模型。



- 亚马逊AWS
 - Amazon Web Services
 - 成立时间：2006年
 - 官网：<https://aws.amazon.com/cn/>
-
- 亚马逊AWS（Amazon Web Services，中文品牌名“亚马逊云科技”）是亚马逊提供的全球云计算平台，从全球数据中心提供超过200项功能齐全的服务，包括亚马逊弹性计算网云（Amazon EC2）、亚马逊简单存储服务（Amazon S3）、亚马逊简单数据库（Amazon SimpleDB）等核心云计算产品。数百万活跃客户覆盖初创公司、大型企业、政府机构及各类行业组织，通过AWS合作伙伴网络（APN）与全球数千家合作伙伴共同推进数字化转型。截至2025年第二季度，AWS在全球云基础设施服务市场份额达32%。



⑨三星电子第六代HBM4芯片开发完成，量产目标2025年底

2025. 12. 03

三星电子近日已成功完成第六代高带宽内存（HBM4）芯片的开发，并正积极进入量产准备阶段。作为全球领先的半导体制造商，三星目前正在向英伟达发送HBM4原型样品，以进行质量测试。这一进展标志着三星在高性能内存技术领域的又一重要里程碑。

据悉，三星的目标是在2025年底前启动HBM4的量产，而非仅是完成开发工作。该芯片的推出预计将为高性能计算、人工智能和图形处理等领域带来显著的性能提升。三星还在积极建立即时量产的系统，以确保能够满足市场需求。

HBM4芯片采用了混合键合（Hybrid Bonding）技术，取代了传统的微凸点连接，预计将为数据中心和高性能计算平台提供更高的带宽（10-11 Gbps）和更低的延迟，进一步推动相关行业的发展。业界普遍期待这一新产品的上市能够为市场带来新的活力。



- 三星电子 (Samsung Electronics)
 - 成立时间：1969年1月
 - 官网：<https://semiconductor.samsung.cn/>
 - 地址：韩国首尔瑞草区
-
- 三星电子是韩国最大的电子工业企业，同时也是三星集团旗下最大的子公司。
 - 三星半导体在存储器、系统半导体和晶圆代工（Foundry）领域驱动技术革新。三星的存储事业部凭借全球领先的存储半导体技术，加速产业数字化转型；系统LSI事业部为运算处理、通信、电源管理及安全等多种应用设计优化核心芯片；晶圆代工事业部则通过尖端制程技术与深度合作，助力客户实现技术飞跃。



⑩存储器价格飙升冲击游戏主机毛利，2026年出货量预估将下调 |

TrendForce集邦咨询

2025. 12. 03

根据TrendForce集邦咨询最新发布报告，受到存储器价格飙涨影响，消费性电子产品整机成本大幅拉升，并迫使终端产品定价上调，进而冲击消费市场。TrendForce集邦咨询继11月上旬下修2026年全球智能手机及笔电的生产出货预测后，此次也下修游戏主机2026年出货预测，从原先预估的年减3.5%调降至年减4.4%。

TrendForce集邦咨询指出，存储器价格飙升冲击诸多终端消费设备，游戏主机此波亦难独善其身。事实上，游戏主机因其获利主要来自软件与会员服务，且意在扩大用户基础，过往多以产品售价逐步下调或定期促销为销售策略。

然而，此次以Switch 2为例，其450美元的首发定价虽高于前代，但考量存储器容量翻倍及颗粒成本上扬，2026年存储器模组占主机总成本的比例将来到21~23%，显示硬件毛利实已被严重压缩，迫使Nintendo（任天堂）恐难如过往预留促销空间。

智能手机、笔电、游戏主机2025~2026年需求成长预估

		2025		2026	
		Revised	Previous	Revised	Previous
Smartphone	YoY	1.6%	0.5%	-2.0%	0.1%
Notebook	YoY	3.6%	3.5%	-2.4%	1.7%
Game Consoles	YoY	5.8%	9.7%	-4.4%	-3.5%

Source: TrendForce, Dec. 2025



Thank you

🏠 江苏省南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼26楼01室(江宁开发区)

☎ TEL:025-84148808 (09:00-17:30)

✉ E-Mail:info@bosikst.com

@ URL:https://www.bosikst.com